

八层pcb盲孔板抄板 八层pcb盲孔板 台山琪翔24小时交货

产品名称	八层pcb盲孔板抄板 八层pcb盲孔板 台山琪翔24小时交货
公司名称	台山市琪翔电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	台山市冲葵镇侨东路22号厂房-2号第二层
联系电话	13712880994 13712880994

产品详情

?pcb多层线路板层数越就越好吗？

八层pcb盲孔板层数越就越好吗？

PCB电路板，可以被看作是一个微型的承载平台，是集成电路的重要载体。Pcb多层线路板的出现，让有限的空间内尽可能地容下越高更复杂的电路，与此同时，还在一定程度上优化了pcb电路板上电路的布局难度系数。好多人会认为：pcb电路板层数越高，性能指标就越好，这是真的吗？

现阶段市场上常用的PCB多层线路板是四层线路板、六层线路板层板，产品精密度越高，对于pcb电路板的层数需求也越高，像航空航天机器设备，pcb层数高达上百层也不惊奇。

八层pcb盲孔板层数越高，布线难度系数也随之提升，因而制造生产成本也相对性较高。但是这并不意味着高层数线路板的性能指标就比低层数的线路板性能高，高层数pcb电路板只不过为了让电子线路获取更大的布线空间，确保细微之处的布线也能有合理化布局。Pcb电路板层数越高，各层之间的电磁干扰越低，因而减低了信号之间的干扰，使得pcb电路板的使用期增加。

八层pcb盲孔板的性能指标不可以和层数划等号，简单的有四层线路板、六层线路板，也有性能指标的。事实上，pcb电路板层数只不过电路板设计时的硬性需求，并不是当作判断PCB电路板好坏的标准。

由于pcb电路板电路板主要是由波织纤维布、树脂和铜箔等原材料组成，原材料自身有一定的厚度，pcb多层线路板的层数越高，这些原材料堆积的层数也就越多，因而，在一定程度上来说，pcb多层线路板和单双层板相比具备更强的刚性。

琪翔电子专注高精密多层rj45线路板、type-c线路板、苹果头线路板，数码线路板，电池线路板等，欢迎新老顾客咨询购买！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：台山市琪翔电子有限公司

高精密多层线路板制作难点

高精密多层八层pcb盲孔板制作难点

高精密多层线路板一般是指8层以上的线路板，比传统的多层线路板加工难度大，其品质牢靠性要求高，首要应用于工业操控，电源、轿车、计算机、消费类电子、航天航空等高科技技术领域。近年来，跟着高精密多层板的需求不断增加，使得高精密多层线路板快速开展。下面琪翔电子给大家介绍一下高精密多层八层pcb盲孔板在生产中遇到的首要加工难点。

对比常规PCB八层pcb盲孔板产品特点，高精密多层线路板具有板件更厚、层数更多、线路和过孔更密布、单元尺度更大、介质层更薄等特性，内层空间、层间对准度、阻抗操控以及牢靠性要求更为严格。

- 1.钻孔制造难点：选用高TG、高速、高频、厚铜类特殊板材，增加了钻孔粗糙度、钻孔毛刺和去钻污的难度。层数多，累计总铜厚和板厚，钻孔易断刀；密布BGA多，窄孔壁距离导致的CAF失效问题；因板厚简单导致斜钻问题。
- 2.压合制造难点：多张内层芯板和半固化片叠加，压合出产时简单产生滑板、分层、树脂空洞和气泡残留等缺点。在规划叠层结构时，需充分考虑资料的耐热性、耐电压、填胶量以及介质厚度，并设定合理的高层板压合程式。层数多，涨缩量操控及尺度系数补偿量无法保持一致性；层间绝缘层薄，简单导致层间牢靠性测验失效问题。
- 3.层间对准度难点：由于高层板层数多，客户规划端对PCB各层的对准度要求越来越严格，一般层间对位公役操控 $\pm 75\mu\text{m}$ ，考虑高层板单元尺度规划较大、图形搬运车间环境温度湿度，以及不同芯板层涨缩不一致性带来的错位叠加、层间定位方式等要素，使得高层板的层间对准度操控难度更大。
- 4.内层线路制造难点：高层板选用高TG、高速、高频、厚铜、薄介质层等特殊资料，对内层线路制造及图形尺度操控提出高要求，如阻抗信号传输的完整性，增加了内层线路制造难度。线宽线距小，开短路增多，微短增多，合格率低；细密线路信号层较多，内层AOI漏检的几率加大；内层芯板厚度较薄，简单褶皱导致曝光不良，蚀刻过机时简单卷板；高层板大多数为系统板，单元尺度较大，在制品作废的价值相对较高。

PCB线路板常见的三种钻孔有哪些？

我们先来介绍下PCB中常见的钻孔：通孔、盲孔、埋孔。这三种孔的含义以及特点。

导通孔（VIA），这种是一种常见的孔是用于导通或者连接电路板不同层中导电图形之间的铜箔线路用的。比如（如盲孔、埋孔），但是不能插装组件引脚或者其他增强材料的镀铜孔。因为PCB线路板是由许多的铜箔层堆迭累积而形成的，每一层铜箔之间都会铺上一层绝缘层，这样铜箔层彼此之间不能互通，其讯号的链接就靠导通孔（via），所以就有了中文导通孔的称号。

特点是：为了达到客户的需求，八层pcb盲孔板的导通孔必须要塞孔，这样在改变传统的铝片塞孔工艺中，用白网完成电路板板面阻焊与塞孔，使其生产稳定，质量可靠，运用起来更完善。导通孔主要是起到电路互相连接导通的作用，随着电子行业的迅速发展，也对印制电路板制作的工艺和表面贴装技术提出了更高的要求。导通孔进行塞孔的工艺就应用而生了，同时应该要满足以下的要求：

- 1.导通孔内有铜即可，阻焊可塞可不塞。
- 2.导通孔内必须有锡铅，有一定的厚度要求（4um）不得有阻焊油墨入孔，造成孔内有藏锡珠。
- 3.导通孔必须有阻焊油墨塞孔，不透光，不得有锡圈，锡珠以及平整等要求。

琪翔电子为您提供各类盲埋孔线路板，欢迎新老顾客咨询购买！